

整理番号

11

分類

機械加工

樹脂成形

治工具

半導体

エムテックスマツムラ カブシキカイシャ

エムテックスマツムラ株式会社

URL: <https://www.mtex.co.jp/>

事業内容

半導体製造装置の開発・設計及び製造 / 半導体モールド金型の開発・設計及び製造
 各種製造装置・合理化設備の設計・製造 / 半導体デバイスの後工程製造
 プラパックス®の設計・製造 / 自動車精密部品の製造

確かな技術でアイデア装置から凡用装置の省力化・高速化を実現

POINT
1

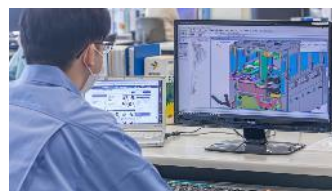
IoT社会へ対応した 多様な製品加工を実現

- 多種多様な自動機を創出してきた経験と、弊社グループ内のライン構築で培った**搬送・センシング・金型成形等の要素技術**を活かし、**生産性と品質安定性を重視した最適なオーダーメイド装置を提案**
- セキュリティ・車載・パワー半導体・RF製品等、IoT社会へ対応する高度化、多様化するニーズに応えます

POINT
2

機械/電気/制御 全領域で設計開発から対応

- 自動化装置の設計・製造における**機械的・電氣的な機構設計のほか、制御系まで内製可能**
- 機械設計・電気設計が専門の**経験豊富な設計者が多数在籍**
お客様の要望に最適な装置を提案します



Check

保有する要素技術：ハンドリング技術（微細加工・装置製造）
 センシング技術（半導体・樹脂成型）
 金型成形加工技術（樹脂成型・自動車部品）
 工程処理組込技術

企業概要

本社所在地

山形県天童市北久野本1-7-43

代表

代表取締役社長 戸田隆

創業/設立

1945年3月

資本金

4億4965万円

従業員数

320名（単体）870名（連結）

支社/工場

天童事業所
 尾花沢事業所
 (株)新庄エレメックス

海外拠点

ベトナム（ホーチミン）

主要取引先

(株)日立パワーデバイス、ルネサスエレクトロニクス(株)、
 (株)デンソー、日本電子(株)他、
 半導体後工程企業 約50社

最大加工/最小加工

金型加工工程：高精度・高硬度加工マシニングセンタ
 (400mm×350mm×150mm)

半導体：最小0.2mm×0.2mm×t0.05mm(半導体チップ)
 最大600mm×400mm×60mm 重量3.0kg (組立集合体)

主要加工材質

金型材料：硬度HRC62～64対応可

精度保証

金型加工工程：
 研削加工精度±0.001、高硬度材切削精度±0.002

プログラミング開発

可 外注対応 不可

機械設計ソフトウェア

iCAD

生産体制

24時間稼働 その他 ※状況により夜勤実施

受注範囲

試作 開発 設計 大量生産 小ロット

取得認証等

・IATF16949 尾花沢事業所工程設計プロセス遠隔地支援拠点
 ・エコアクション21

資格保有者

設計：M/C設計11名、E/C、ソフト設計6名、金型設計3名
 金型加工工程：
 平研研削1級・2級・・・11名、機械検査2級・・・9名
 マシニングセンタ1級・・・2名、
 ワイヤー・型彫放電1・2級・・・6名

お問合せ先

TEL :023-654-9055 FAX :023-654-9052

mail : satou.yoshiharu@mtex.co.jp

担当：営業技術課 佐藤義治